

HY400 系列 导热界面材料
Series Thermal Interface Material

专为电子零部件降温设计的导热界面材料
 Special Design for Electronic Components Heat Transfer

项 目 Items	HY410	HY420	HY430	HY450	单位Unit
颜色 Color	白色 White	白色 White	白色 White	白色 White	No
热传导系数 Thermal Conductivity	>1.42	>1.63	>1.84	>2.15	W/m-K
热阻抗 Thermal Impedance	<0.252	<0.249	<0.227	<0.125	°C-in ² /W
比重 Specific Gravity	>2	>2	>2.1	>2.3	g/cm ³
粘度 Viscosity	1000	1000	1000	1000	No
浓度 Thixotropic Index	380±10	350±10	320±10	300±10	1/10mm
瞬间耐温度 Moment Bore Temperature	-50~300°C	-50~340°C	-50~340°C	-50~340°C	°C
工作温度 Operation Temperature	-30~280°C	-30~300°C	-30~300°C	-30~300°C	°C

HY400

成份Ingredients

矽化合物 Silicone Compounds	35%	35%	45%	55%	%
碳化合物 Carbon Compounds	45%	35%	25%	15%	%
氧化金属化合物 Metal Oxide Compounds	20%	30%	30%	30%	%
包 装 Package	软管 ST	迷你包 SP	针管 TU	罐装 CN	吊卡 Other
	20g~25g	0.5g~5g	0.5g~30g	10g~1000g	0.5g~5g

产品图片Products Pictures

ST	SP	TU	CN	Other
				

执行标准：Q/HYTG 001-2017

※本产品耐温，不自燃，一般常温储存方式即可。

Thermal Interface Materials, Non-Spontaneous In room Temperature

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得，该实验室保留最终解释权。

All data above provide by Shenzhen Halnziye Electronics Co.,Ltd. Halnziye All Rights Reserved